

檔 號：  
保存年限：

# 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 函

地址：106台北市和平東路二段  
106號16樓

傳真：02-27377730

聯絡人：陳彥君

聯絡電話：02-27377679

電子郵件

：ycchen@mail.stpi.org.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國98年1月17日

發文字號：國研政趨字第09808000440號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如附（2009年第一梯次簡章核定板970110.doc、STB計畫申請表-中文971110.doc、STB計畫申請表-英文971110.doc，共3個電子檔案）

主旨：本中心承辦執行國科會「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program)。2009年第一梯次申請截止日期為2009年2月14日，敬請各單位協助公告週知並請踴躍參加。

說明：

- 一、為培育台灣高階醫療器材的跨領域人才，本中心承辦執行國科會「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program；以下簡稱STB)。希望透過與美國史丹福大學合作，甄選出由工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學接受培訓課程之醫療產品設計及商業化運用的實務訓練。透過培訓課程的臨床觀察、動物試驗、核心實驗室、產品專利佈局、法規認證等實務訓練及與產業界互動之過程，期望由不同領域之專業角度，瞭解臨床醫療運用上的創新價值，進而產生創意的改良設計，並尋求創業的機會。為台灣高階醫療器材產業培養創新與創業人才。
- 二、2009年第一梯次即日起開始接受申請，截止日期為2009年2月14日。報名方式請閱讀附件之簡章，相關招生訊息請逕自STB計畫網站(stb.stpi.org.tw)查詢。



裝

訂

線

正本：國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺南大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立聯合大學、國防醫學院、大同大學、大同技術學院、大葉大學、中山醫學大學、中原大學、中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學、中華大學、中華技術學院、中華醫事科技大學、中臺科技大學、元培科技大學、元智大學、世新大學、台北海洋技術學院、台南科技大學、弘光科技大學、亞東技術學院、亞洲大學、明志科技大學、東吳大學、東南科技大學、東海大學、長庚大學、長庚技術學院、長榮大學、南台科技大學、南亞技術學院、高雄醫學大學、崑山科技大學、淡江大學、清雲科技大學、逢甲大學、朝陽科技大學、慈濟大學、義守大學、嘉南藥理科技大學、實踐大學、臺北醫學大學、輔仁大學、輔英科技大學、遠東科技大學、銘傳大學

副本：

98/01/17  
14:50:08